

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-027

北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式送达。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由公司董事长刘强先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 13 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 4.2934 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未归属的 4.2934 万股第二类限制性股票。

公司提名与薪酬委员会对本议案进行了审议，并发表了同意的意见。

《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定向符合归属条件的336名激励对象办理116.2231万股第二类限制性股票的归属事宜。

公司提名与薪酬委员会对本议案进行了审议，并发表了同意的意见。

《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司关联董事黄磊回避表决。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3、审议通过《关于向全资子公司芯成半导体（上海）有限公司增资并对合肥君正科技有限公司减资的议案》

根据公司总体规划，经公司第六届董事会第二次会议和2024年年度股东大会审议通过，公司将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”。公司将对原承担“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”的全资子公司合肥君正科技有限公司进行减资，“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”结余的募集资金加现金管理收益及利息扣除银行手续费净额23,560.28万元将由公司通过全资子公司北京矽成半导体有限公司向承担“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”的芯成半导体（上海）有限公司进行增资。

《关于对部分全资子公司进行增资和减资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会提名与薪酬委员决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日